

激光高速精密微锡焊系统

WL-1K20/50/70/100-MO系列



激光高速精密微锡焊系统

产品介绍

该系统使用高速运动系统辅助激光焊锡，可以实现惊人的加工效率，同时，为了实现对于传统生产线的自动化接入，本机可以选配视觉识别自动对位系统，实现高度的自动化生产。通过实践比较，一台整机的实际产能可以超过到数十名熟练工人的生产量。

产品特点

- 焊锡效率高，尤其适合多焊点大批量生产，可以一次性高速完成数十个焊点的加工；
- 自动化程度较高，CCD成像实时观察加工情况，也可以选配视觉识别自动对位系统，实现高度自动化生产；
- 焊接效果优良，焊点饱满，一致性较好；
- 加工精度较高，光斑可以达到微米级，加工时间程序控制，精度远高于传统加工方式；
- 非接触式加工，不存在接触焊接导致的应力；
- 细小的激光束替代烙铁头和热压焊嘴，在加工件表面有其他干涉物时，同样便于加工；
- 局部加热，热影响区小；
- 全封闭结构，加工无污染，无静电威胁，操作使用安全；
- 设备扩展功能强，适合加工多种复杂加工件情况；
- 加工程序设定简单，便于操作。

应用领域

在极细同轴线与端子焊，USB排线焊、软性线路板FPC或硬性线路板PCB焊，高精密的液晶屏LCD、TFT焊及高频传输线等方面，由于对于精密加工的要求越来越高，而且基于线材品质的需要，传统工艺已难以有效解决相关问题，采用激光高速精密焊锡系统将是最佳选择。

样品展示

